

國立中山大學半導體及重點科技研究學院
111學年度第一屆碩士班
線上招生說明會

學院創新培育規劃+學生常見問題回答

黃 義 佑 副校長兼研究學院院長

2022/4/17

簡報大綱

□ 學院創新培育規劃

□ 學生常見問題回答

□ 學院招生報考說明

國立中山大學研發與產學合作績效

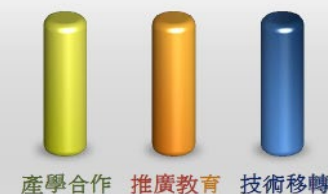
- 國立中山大學為大高雄地區(人口數約277萬人)中唯一具備研究學院申請條件的頂尖大學：
1. 國立大學之國際聲望(2020年QS世界排名前500名)—本校2020年QS世界排名為416名(2021年為412名)
 2. 產學合作表現(企業資助產學合作經費於2017至2019年之3年經費總額達國立大學前30%，約1.58億元)
—本校2017至2019年企業資助產學合作經費總額約5.04億元
 3. 人才培育能量(108學年度達國立大學前30%，約1萬名學生及450名專任教師)
—本校108學年度學生數9,563名、專任教師541名

QS全球大學學科排名	2018 入選科目數量	2019 入選科目數量	2020 入選科目數量	2021 入選科目數量	2018-2021 四年變化幅度
臺灣大學	36	36	36	40	+4
成功大學	26	23	24	24	-2
清華大學	18	19	20	21	+3
交通大學	20	18	18	18	-2
中山大學	12	15	16	17	+5
臺灣科技大學	12	11	13	14	+2
政治大學	12	12	12	13	+1
中央大學	13	14	14	12	-1
臺灣師範大學	10	11	11	10	0
中興大學	9	11	11	9	0

近五年的產學績效，為十年前的兩倍！



106-110年產學績效



產學合作：

1. 政府機關產學合作計畫
2. 科技部產學合作計畫
3. 非政府機關產學合作計畫

推廣教育：

- 學分班、專業訓練課程、企業委訓課程

技術移轉：

- 職務成果與專利之技術授權



遠見雜誌》設半導體學院、培育產業人才，中山大學加入「護國」行列！

- 根據104人力銀行調查，自2015至2021年間，台灣半導體產業的整體人力缺口，最低約為1.7萬人，最高則落在去年的Q4，達3.4萬人。台經院的數據也顯示，2019年，台灣半導體產業雇用人數為22.5萬人，去年急速攀升至超過29萬人，等於台灣半導體產業的1600家企業中，過去兩年平均一年增加3萬多的人才缺口，「29萬人代表著29萬個家庭，加上半導體產業還會帶動其他產業，例如軟性服務業、百貨業、餐飲業等，當市場大到一定的規模，國家就有必要持續扶植」，黃義佑點出關鍵。
- 確實，為了解決半導體人才的需求問題，2020年，總統蔡英文特別指示行政院召開跨部會會議，鬆綁相關法規，並進一步訂定「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」。2021年5月，條例順利經立法院三讀通過，台、成、清與陽明交大先後通過成立半導體學院，中山做為積極響應國家政策的頂尖大學，今年1月，進一步成為第五間獲選的學校。



遠見雜誌》設半導體學院、培育產業人才，中山大學加入「護國」行列！

- 黃義佑強調，學院師資由大學教授與產業專家共組，團隊會擬定符合產業發展所需的專業課程地圖和專題技術研究主題，「學校與企業針對學制、師資、課程等方面進行溝通，我們只花了三個月，就確定了合作細節，」他透露，中山與高雄在地、封測產業的日月光集團、華泰電子、穎崴科技，以及電子零組件產業的國巨、雷科、穎崴科技、興勤電子、台虹科技合作，**七間企業同意未來10年挹注約9億元在中山半導體學院，加上國發基金約8億元的補助，等於會有17億元預算。所有學生將能獲得約100萬獎學金，並在實習結束後，直接選擇進入企業就業，「等於讓學生念書時沒有經濟壓力，還能使用企業昂貴的設備，學到最先進的know how，畢業後又可立刻就業。這對學生、家庭、學校、產業、國家來說，是多贏的局面。」**
- 值得注意的是，相較台、清、成和陽明交大紛紛鎖定IC設計、晶圓製造等半導體產業的上中游領域開課，中山的兩間研究所，則瞄準下游封測與電子零組件產業。黃義佑指出，目前台灣的主流目光放在IC設計和晶圓製造領域，但2021年，台灣半導體產業產值為台幣3.5兆元，其中，**封測總產值約為6400億元，而電子零組件產業的產值則為1.5兆元，半導體封測及電子零組件這兩個領域不僅產值大，更不乏類似日月光集團及國巨等企業這樣，位居全球第一或領先地位的國際大廠，「我們（中山大學）做為高雄在地學校，與相關領域在地大廠合作，能讓北漂青年因為好的學習、工作機會回來，常伴長輩身邊，城市發展有了年輕人，也能緩解南北失衡的情形。這是在解決社會問題。」**

7家出資企業皆為國家重點領域產業之上市櫃國際標竿公司

→ 公司名稱：日月光投控 → 公司代號：3711 → 產業類別：上市半導體業

公司基本資料

董事長	總經理	發言人	聯絡電話	公司網址
張虔生	張洪本	吳田玉	07-3617131	www.aseglobal.com
公司地址		主要經營業務		實收資本額
高雄市楠梓區經三路26號		H201010 一般投資業		44,034,145,820

→ 公司名稱：華泰 → 公司代號：2329 → 產業類別：上市半導體業

公司基本資料

董事長	總經理	發言人	聯絡電話	公司網址
董悅明	涂家榮	洪士民	(07)361-3131	www.ose.com.tw
公司地址		主要經營業務		實收資本額
高雄市楠梓區中三街9號		積體電路、各種半導體零組件、各種電子、電腦及通訊線路板		8,270,820,330

→ 公司名稱：穎崙 → 公司代號：6515 → 產業類別：上市半導體業

公司基本資料

董事長	總經理	發言人	聯絡電話	公司網址
王嘉煌	王嘉煌	李振昆	07-3610999	https://www.winwayglobal.com/
公司地址		主要經營業務		實收資本額
高雄市楠梓區創意南路68號		半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組		338,820,000

→ 公司名稱：國巨 → 公司代號：2327 → 產業類別：上市電子零組件業

公司基本資料

董事長	總經理	發言人	聯絡電話	公司網址
陳泰銘	王淡如	宋志翔	(02)6629-9999	WWW.YAGEO.COM
公司地址		主要經營業務		實收資本額
新北市新店區寶橋路233-1號3樓		被動元件、電阻原料半成品		4,959,188,570

→ 公司名稱：雷科 → 公司代號：6207 → 產業類別：上櫃電子零組件業

公司基本資料

董事長	總經理	發言人	聯絡電話	公司網址
鄭再興	黃萌義	唐靜玲	07-8159877	www.lasertek.com.tw
公司地址		主要經營業務		實收資本額
高雄市前鎮區新生路二四八之三十九號		表面黏著元件&SMD捲裝材料		838,735,890

→ 公司名稱：興勤 → 公司代號：2428 → 產業類別：上市電子零組件業

公司基本資料

董事長	總經理	發言人	聯絡電話	公司網址
隋台中	何益盛	何益盛	07-5577660	www.thinking.com.tw
公司地址		主要經營業務		實收資本額
高雄市三民區民族一路373巷21號		機械陶瓷、熱敏電阻、變阻體、陶瓷電容器製造加工買賣		1,281,127,260

→ 公司名稱：台虹 → 公司代號：8039 → 產業類別：上市電子零組件業

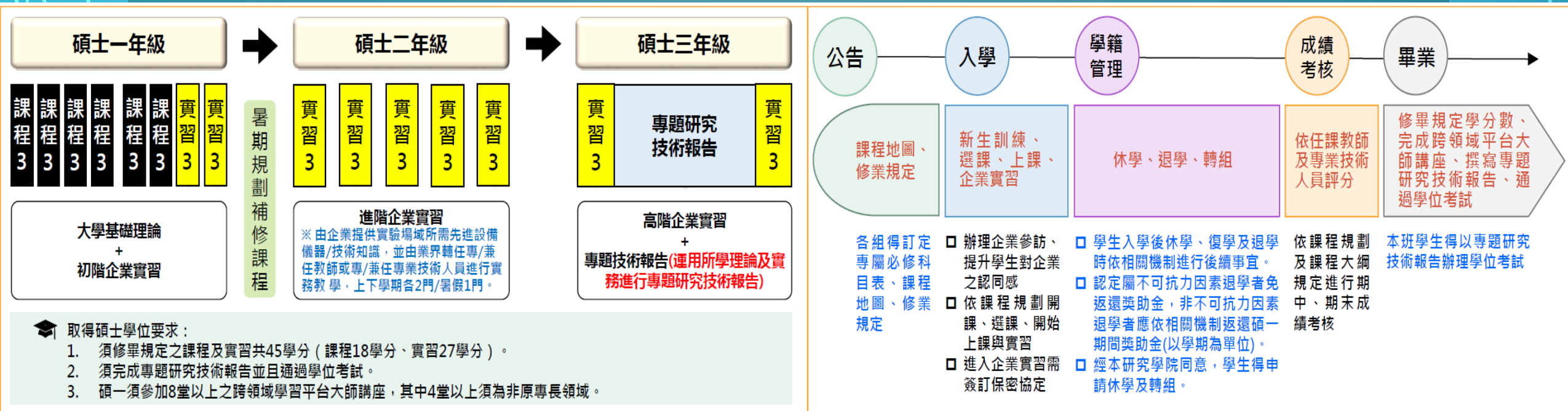
公司基本資料

董事長	總經理	發言人	聯絡電話	公司網址
孫達汶	江宗翰	潘祈愿	07-8139989	www.taiflex.com.tw
公司地址		主要經營業務		實收資本額
高雄市前鎮區環區三路一號		高分子薄膜銅箔積層板		2,091,196,920

產業名稱	企業名稱	員工數(名)	預估人才缺口 (名/10年)	出資金額 (億元)
半導體封測	日月光	101,981	1,000	9.07
	華泰	5,568		
	穎崴	676		
電子零組件	國巨	30,333	500	
	雷科	266		
	興勤	4,155		
	台虹	1,098		
	穎崴	676		
合計		144,077	1,500	

7家合作企業2020年合計營收約**5,773億元**，
2021年合計營收超過**6,400億元**，年成長率**10.86%**

半導體及重點科技研究學院修業規劃及入學學籍課程管理機制



□ 垂直/橫向整合產業鏈科技人才創新培育模式

- 有鑑於電子零組件為台灣經濟極重要且不可或缺的一環，其產業人才缺口問題的急迫性不亞於半導體產業。因此，國立中山大學申設半導體及重點科技研究學院，除成立「先進半導體封測研究所」，同步成立「精密電子零組件研究所」，採創新垂直/橫向整合產業鏈科技人才培育模式(非僅為單一公司培育人才，同意出資合作企業共7家)，以補足台灣半導體產業鏈完整拼圖所需封測、零組件與設備相關科技人才缺口。

□ 1+2學年制產學共育機制消弭學用落差問題

- 第1年：學生大部分在本校修課及少部分至業界進行初階實習
- 第2年：學生須密集至業界參與進階實習且由業界轉任本校專/兼任教師或專業技術人員擔任企業實務授課老師
- 第3年：學生將至企業運用其精密設備儀器及所學知識進行高階實習與產業問題之研發，並且完成專題研究技術報告，經學位考試後方能取得學位。每一位學生需由專任教師或專業技術人員擔任指導教授，其中大學教授需搭配業界專/兼任教師或專業技術人員擔任共同指導教授

半導體及重點科技研究學院招生人數與入學機制

- 建立同領域不同企業聯合招生、提供近**100萬元**之高額獎助學金、學生可依其意願提前選擇就業進路
 - ✓ 招生前公告本學院修業規劃、修業期間提供業界實習場域及本研究學院獎助學金額度等資訊，並經報考學生同意填寫報名表、企業實習保密協定與退場後獎助學金返還機制同意書。
 - ✓ 採取聯合招生，並依學生選填志願分發。
- 依據重點產業科技發展需求訂定專題研究主題，擴大產學合作績效
 - ✓ 本學院會訂定專題研究技術報告之認定基準。

先進半導體封測研究所
(80人)

精密電子零組件研究所
(40人)

被動元件組(20人)

電子零組件及設備組(20人)

1. 為有效解決國家重點產業科技人才缺口問題，本學院採取多元取才及有條件部分流用的策略，規劃兩研究所採書面審查進行招生。
2. 考生應於考試前填寫志願組別，後依其考試成績與選填志願序進行分發。
3. 招生簡章須公告修業與學程規劃、獎助金額度等相關資訊。

完成報名
選填志願



書審
(100%)

由本校教師與業界轉任專/兼任教師及
專業技術人員共同參與



依志願序
進行分發

增加企業選才及
考生錄取機會



錄取缺額流
用(需經招生
委員會同意)

增加各所/組名
額之使用率

先進半導體封測研究所課程結構表(暫定)

學期	碩一必修課程 (每學期2選1)	碩一規劃開設選修課程-12學分(上學期8選3、下學期8選1)		
上學期	半導體製程整合技術	應用力學與材料力學	智慧製造與控制實務	材料科學
	半導體工程師必備知識	高分子材料	微機電元件與技術專題	系統層級靜電與電磁干擾
		微波電路與系統	產品分析	
下學期	系統電路設計與測試	半導體元件特性量測分析	雷射微加工於電子封裝之應用	高頻高速電路模擬與量測
	高階電子封裝結構設計與製程技術	影像辨識	有機半導體材料與元件	工程統計與品質管理
		光電半導體技術	品質系統與改善	

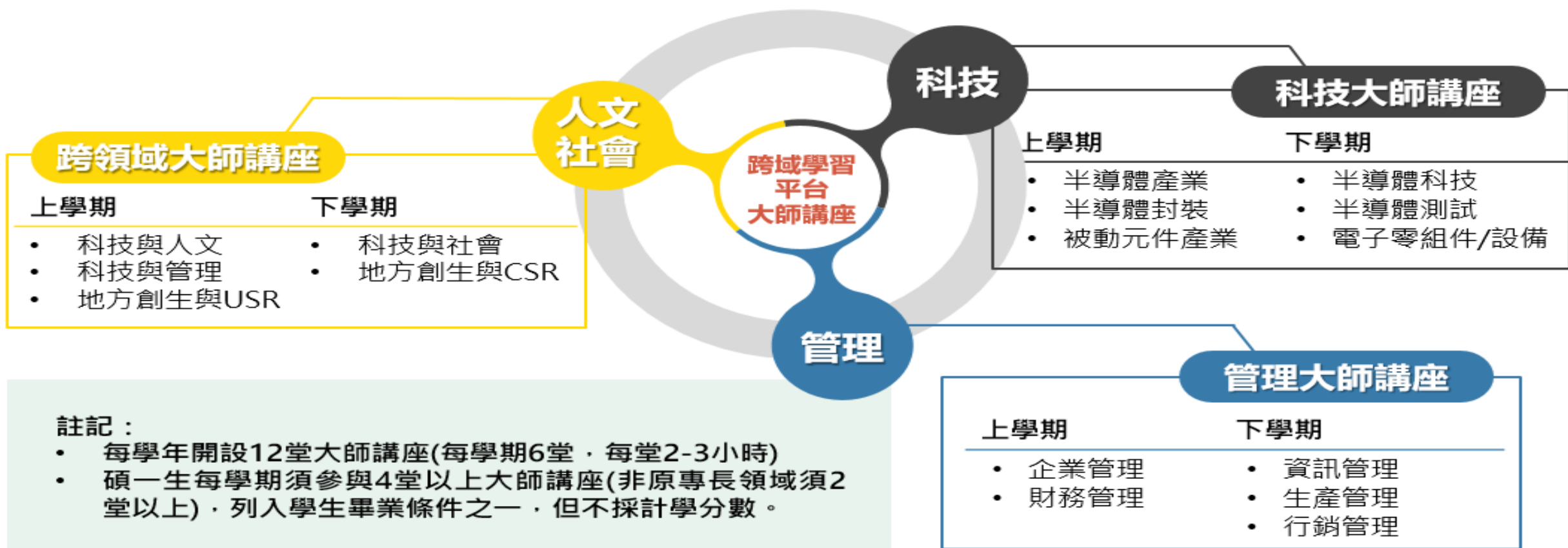
組/班別	碩一~碩三規劃開設必修實習課程-27學分	備註
先進半導體封測研究所企業實習課程	碩一、二課程各開兩班-由不同老師授課 ● 碩一：半導體製程介紹與趨勢發展、統計學應用 ● 碩二：問題分析與解決工具、專業課程與應用(一)、五大核心工具應用、專業課程與應用(二)、車用電子產品實務 ● 碩三：專業課程與應用(三)A、專業課程與應用(三)B	● 碩一第二學期開設4門(學生應選2門) ● 碩二開設10門(學生每學期選2門、暑期選1門) ● 碩三開設2門(學生每學期選1門) ● 每門課各3學分

精密電子零組件研究所課程結構表(暫定)

學期	碩一必修課程 (每學期2選1)	碩一規劃開設選修課程-12學分(上學期選3門、下學期選1門)		
上學期	材料科學	電子陶瓷	陶瓷材料與製程	材料分析
		被動元件量測與電路設計	高分子材料	薄膜工程與檢測技術
	半導體工程師必備知識	微機電元件與技術專題		
下學期	半導體製程整合技術	工廠管理	被動元件導論	汽車業五大核心工具及過程稽核實務
	積層陶瓷元件			

組/班別	碩一~碩三規劃開設必修實習課程-27學分	備註
精密電子零組件研究所—被動元件組企業實習課程	● 碩一：電阻元件原理暨應用概論與實習、陶瓷介電材料基礎理論與實習 ● 碩二：LTCC製程實現LC諧振電路簡介、MLCC 製程概要與實習(一)、MLCC 製程概要與實習(二)、鈦酸鋇粉末合成材料導論與實習、產品生命週期管理產品開發模式實務 ● 碩三：積體陶瓷電容微結構與缺陷分析實務、電阻信賴性試驗、規範與實務	● 碩一第二學期開設2門(學生應選2門) ● 碩二開設5門(學生每學期選2門暑期選1門) ● 碩三開設2門(學生每學期選1門) ● 每門課各3學分
精密電子零組件研究所—電子零組件及設備組企業實習課程	● 碩一：統計與實驗設計實作、雷射加工應用與工業製程設計實作 ● 碩二：品質工程與可靠度工程實習、高分子加工實作、熱敏與壓敏電阻器製造及應用實作、機械設計與工程圖學實作、高頻測試與材料應用實作 ● 碩三：工程力學實習、專利基礎知識與應用實務	

半導體及重點科技研究學院跨領域學習平台(暫定)



□ 建立跨領域(科技、管理與人文社會)知識學習平台

- ✓ 本校申請設立一所可以兼顧跨領域特色及人文社會教育的半導體及重點科技研究學院
- ✓ 除了授予學生先進半導體封測與電子零組件專業科技以外，將輔以本校優質社科、管理學院之社會科學、企管/資管/財管/行銷相關知識，並連結本校既有人文講座及地方創生相關社會教育資源，建立「跨領域(科技、管理人文社會)多元學習平台」，以激發跨域火花與強化多元學習成效。
- ✓ 講座主題會因應國際發展酌予調整，例如增加SDGs、循環經濟及淨零排放等議題的講座，以利學生掌握趨勢。

半導體及重點科技研究學院招生簡章/報名系統網站



國立中山大學

National Sun Yat-sen University

半導體及重點科技研究學院

College of Semiconductor and Advanced Technology Research, NSYSU

111學年度碩士班招生

先進半導體封測研究所 | 精密電子零組件研究所

半導體國家隊 獎學金近百萬
沒有經濟壓力 畢業立即就業

- 因應半導體及重點科技產業人才迫切需求，本院採取一年大學授課加兩年企業實習與研究的創新產學培育機制。
- 本院與七家高雄在地半導體封測及電子零組件標竿企業合作，由企業提供高額獎助學金、先進完備的實習場域（含設備儀器）、業界最新技術/know-how，及業界師資共同指導學生進行企業實務專題研究技術報告。

報名日期

111.4.8(五) 中午12:00 ▶ 5.2(一) 下午17:00

考試項目

- 審查【佔100%】
- ①自我介紹2分鐘短片(請提供影片網址)
 - ②大學歷年成績單(需含學業成績總名次證明；同等學力者以最高學歷歷年成績單代替)
 - ③參與撰寫之研究報告、專題報告、學術論文或其他有助審查之相關資料

招生名額

先進半導體封測研究所

▶ 一般生80名

精密電子零組件研究所

▶ 一般生共40名

下設「被動元件組」(20名碩士生)及「電子零組件及設備組」(20名碩士生)入學時不分組招生，於碩一上至碩一下時進行意願分組

報考資格

- 理工相關科系學士(含應屆畢業生)及同等學力學生

費用

- 1,000元 ※(中)低收入戶及特殊境遇家庭學生免繳報名費

獎學金

- 碩一：提供一年16萬元獎助學金
- 碩二、碩三：提供企業實習機會，每月3.5-4萬元實習獎助學金

合作企業

先進半導體封測研究所：日月光半導體、OSE 華泰電子、winway 穎威科技

精密電子零組件研究所：YAGEO 國巨、雷科(股)公司、興勤電子、TAIPEX 台欣科技

WinWay 穎威科技

補助單位 國家發展委員會
National Development Council

督導單位 教育部
Ministry of Education



簡章下載



報名系統



認識系所

國立中山大學教務處首頁→招生最新消息

<https://oaa.nsysu.edu.tw/p/406-1003-278658,r867.php?Lang=zh-tw>



簡章下載



報名系統



認識系所

簡報大綱

□ 學院創新培育規劃

□ 學生常見問題回答

□ 學院招生報考說明

半導體及重點科技研究學院學生常見問題回應

一、有關畢業證書學位名稱會是這學院名稱嗎？

1. 本學院為「半導體及重點科技研究學院」，設有「先進半導體封測研究所」及「精密電子零組件研究所」，其目的為厚植我國半導體封測及電子零組件產業在國際市場的領先地位及永續競爭力。
2. 兩個研究所都會針對其專業領域進行人才培育，強調專業能力、產業實務能力及跨領域視野的養成，學位證書會註明學院、研究所及分組名稱，因研究學院仍為培育工學領域碩士，證書註記學位為：「工學碩士學位」。

二、請問研究學院與原有系所差別

1. 本研究學院依國家重點領域產學合作及人才培育創新條例通過設立，聚焦大高雄已居國際領先地位之半導體封測及電子零組件產業的人才缺口問題，採取垂直/橫向整合產業鏈需求及1年大學授課+2年企業實習的創新產學共育方式，由大學教授與產業專家組成師資團隊及共擬符合產業發展所需的專業課程地圖及專題技術研究主題，合作企業提供實習場域(包括先進設備與儀器)並參與共同指導學生，讓學生的專業能力培育得以充分對接國家重點產業發展的實務需求，以補足臺灣半導體封測與電子零組件產業的科技人才缺口及永續其國際領先地位。
2. 本研究學院透過產學共育將有對接產業的課程設計、具實務專業能力的師資、企業提供的先進設備及Know-how，培育學生具備產業所需的專業實務能力，是與現有系所最大的差別。

半導體及重點科技研究學院學生常見問題回應

三、請問與企業合作模式為何？是否包含就業保證？研發實習如何媒合實習企業？合作廠商一定有實習名額嗎？

1. 本研究學院採取垂直/橫向整合產業鏈需求及1年大學授課+2年企業實習的創新產學共育方式進行。由大學教授與產業專家組成師資團隊及共擬符合產業發展所需的專業課程地圖及專題技術研究主題。合作企業提供實習場域(包括先進設備與儀器)並參與共同指導學生，讓學生的專業能力培育得以充分對接國家重點產業發展的實務需求。
2. 本研究學院引進企業資源，由業界投入培育經費、實習場域所需精密設備儀器、技術與知識、業界師資及相關支援人力，並提供學生在校就學期間之修課/實作獎助金，及學生畢業後至培育企業就業的機會。
3. 學生於畢業後若選擇進入培育企業就業滿兩年，則免返還任何在學三年期間所領的獎助學金(近100萬元)；反之，若學生畢業後未選擇進入培育企業服務，也僅需返還碩一期間所領取之16萬元獎助學金。
4. 精密電子零組件研究所學生於碩一上至碩一下之寒假期間，會依學生志願及修業成績等條件進行分組。兩個研究所均會在碩一升碩二時，在學生於第一年對共同培育企業有所認識後，依學生意願及修業狀況分發至培育企業進行實習，相關媒合分發均會考量學生意願進行。
5. 各研究所之合作培育企業在招生前就會依產業需求設有培育名額限制。

半導體及重點科技研究學院學生常見問題回應

四、從本研究學院畢業後學生需要綁定合作企業工作嗎？

1. 學生從本研究學院畢業後，本學院會尊重學生之意願選擇畢業後之進路，而不會要求學生一定要到合作企業工作，但學生若選擇依其原先所簽意願進入出資合作企業服務符合本研究學院培育國家重點產業發展所需科技人才之成立宗旨。
2. 本研究所學生入學後，即依修課進度領取**碩一時每學期8萬元「修課獎助學金」**及**碩二、碩三時可領取平均約達每月3.5萬至4萬之「實習獎助學金」**，其資金來源包含國家及企業資金，目的是讓同學於在校修業期間較無經濟壓力，其受領之獎助學金依本研究學院學生參與實習保密及獎助金核發機制約定，會附帶學生畢業後至參與實習公司就業之服務規範，**服務期間至多以學生畢業後二年為原則**。學生於畢業後若選擇進入培育企業就業滿兩年，則免返還任何在學三年期間所領的獎助學金(近100萬元)；反之，若學生畢業後未選擇進入培育企業服務，也僅需返還碩一期間所領取之16萬元獎助學金。
3. 本研究學院之合作培育企業均是相關領域之國際標竿企業，對本研究學院的畢業生將是非常適合的發展進路，**但不會以綁定的方式要求培育學生至企業服務**。

半導體及重點科技研究學院學生常見問題回應

五、請問大學部所修的學分是否能抵免學院的學分？

本研究學院學生於入學前若於大學部曾修習相關研究所課程，且該課程學分未計為大學部畢業學分，則可依本校抵免學分辦法向所屬研究所提出抵免申請，經所屬研究所核可後，方得抵免各研究所規定之必選修學分。

六、請問畢業論文撰寫有甚麼樣要求？畢業論文有要求與相關領域相符嗎？碩論題目需要和業界合作公司相關嗎？是否有規定要發表幾篇國際論文期刊？

1. 本研究學院學生之碩士學位論文採專題研究技術報告方式進行，技術報告之主題應與指導教授及共同指導教授(業界轉任專/兼任教師或專業技術人員)研訂契合產業發展或解決產業實務問題的研究主題，其主題應與研究所相關產業之專業領域有關，不限定與合作企業相關。
2. 學生申請學位考試前需修習規定之學術倫理課程，取得學位之專題研究技術報告仍應符合本校論文原創性比對之規定。
3. 本研究學院各研究所並未規定學位考試前需完成國際論文期刊發表之要求。

半導體及重點科技研究學院學生常見問題回應

七、請問進行模式以修課為主或以實習研究為主？

本研究學院採1+2之創新培育方式，一年修課、二年實習，碩一完成課程18學分及參與跨領域學習平台大師講座8堂以上，以培育學生專業能力及跨領域之視野，碩二進行進階企業實習，碩三進行高階企業實習及專題技術報告之撰寫，兼顧理論及實務，以培育具專業實務能力之半導體封測及電子零組件產業科技人才。

八、企業實習是否計入工作年資？

本研究學院採1+2學制，碩一在學校修習專業課程及初階企業實習，碩二及碩三則以安排至企業進行進階及高階實習課程，並進行實務專題做為專題研究技術報告進行學位考試，在校期間可領取高額獎助學金(不是薪資)，但實習課程仍為課程的一部分，學生於在學期間至合作企業實習，為本研究學院為提升其專業智識所進行之職場屬性實務學習課程，學生並非該實習企業的勞工，應不計入就業年資。

簡報大綱

- 學院創新培育規劃
- 學生常見問題回答
- 學院招生報考說明

半導體及重點科技研究學院招生報考說明

1. 報名前請詳閱簡章
2. 備好證件照片檔案
3. 備妥審查資料電子檔
含兩分鐘影片連結
4. 報名費1000元
ATM、土銀臨櫃、信用卡繳交
(中)低收入戶及特殊境遇家庭學生得
申請免繳報名費
5. 繳費1小時後,可繼續至報
名網站登妥報考資料
6. 寄繳資料
實習保密切結、獎助金核發與返還
同意書、國外學歷切結等

國立中山大學半導體及重點科技研究學院 111 學年度碩士班招生考試簡章

重要日程表

項 目		時 程
報名	1.上網取得繳費帳號及報名專用碼	111.4.8 (五) 12:00~5.2 (一) 17:00 • 考生登錄完成後,務必再到報名系統【已完成報名登錄者查詢】檢查確認個人報考資料,並留存流水號方為報名完成。 • 報名資料依報考身分規定上傳(請參考參·報名手續及注意事項→四、應上傳(寄繳)資料) • 於上述期限內取得繳費帳號及報名專用碼者,其餘步驟均可於111.5.3 (二) 17:00 前補登錄。 • 未於報名登錄時間截止前上網確認,後發現錯誤致權益受損,考生應自行負責,概不受理更改或補救。
	2.繳交報名費	
	3.相片上傳	
	4.上網登錄報名資料	
	5.上傳報名必要資料	
	6.上傳備審資料及補登資料	
寄件	切結書※視報考學歷(力)需要而定	掛號郵寄 111.5.3 (二) 止 (國內郵戳為憑) 自行送件 111.5.3 (二) 17:00 止
上網列印「應考證」		111.5.6 (五) 12:00 起 (預定)
上網申請退費 ※本校至遲於 111.6.30 前匯款退費		111.4.12 (二) 12:00~5.11 (三) 12:00 ※不符退費資格及逾時申請者不予退費
教務處網頁公布錄取名單		111.6.2 (四) 17:00 (預定)
上網補印成績單		111.6.6 (一) 17:00 起
上網申請複查		111.6.7 (二)
正取生報到日期		6.9 (四)~6.10 (五) (預定)
備取生遞補期限		111 學年度第一學期行事曆所定開始上課日

半導體及重點科技研究學院招生報考說明

◆報考資格

- ◆凡國內經教育部立案之各公私立大學校院或符合教育部採認規定之境外大學校院理工相關科系畢業
(理工相關科系不限電機、機械、材料等，化學、物理、海工等取得理工學位者)
- ◆取得學士學位或學士班應屆畢業生(於 111 年1 或 6 月畢業)
- ◆符合提前畢業標準及延長修業期限者，或具入學大學碩士班同等學力

◆修業年限(在校修課期間學費比照本校工學院碩士班標準收費)

- ◆1至3年，需延長修業年限至4年者，須向系所提出申請

半導體及重點科技研究學院招生報考說明



半導體及重點科技研究學院招生報考說明

◆考試項目：

審查【佔 100%】

請將下列資料存成 pdf 檔上傳：

◆審查基本資料表(請依本所格式)

含2分鐘自我介紹短片連結

◆大學歷年成績單

需含學業成績總名次證明；同等學力者以最高學歷歷年成績單代替

◆讀書計畫

◆其他有助審查之相關資料

參與撰寫之研究報告、專題報告或學術論文等

國立中山大學半導體及重點科技研究學院碩士班 先進半導體封測研究所、精密電子零組件研究所聯合招生 審查基本資料表

姓 名		在 校 學 業 均 成 績		在 校 排 名 (系)	名次:
身分證字號					人數:
畢 業 學 校	大 學 (學 院)		學 系	年	月 畢 業
若有報考其他學校研究學院者，請列舉：					
1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____					
2 分鐘自我介紹短片(請提供可正常點閱之影片網址)：					
一、學術成就	已發表或參與之學術研究報告電子檔(至多列舉三項；請擇優附上乙份研究報告，並置於「4、其他有助審查之相關資料」。)。				
	1				
	2				
	3				
註：若有大學部專題請上傳至「4、其他有助審查之相關資料」中					
二、外語能力	1				
	2				
	3				
三、特殊成就	1				
	2				
	3				
四、課外活動	1				
	2				
	3				
備註	1.如有具體表現每項請擇優列出三項，並上傳證明文件至「4、其他有助審查之相關資料」，如有填寫不實則依相關規定辦理。 2.不需推薦函。				

半導體及重點科技研究學院招生報考說明

◆考生請詳閱本研究學院「學生參與實習保密及獎助金核發機制」

◆規範參與企業實習課程應簽署參與實習保密切結。

◆規定受領獎助金事項及服務年限規定：

◆獎助金金額

◆服務規範

◆簽署獎助金返還同意書

國立中山大學半導體及重點科技研究學院 學生參與實習保密及獎助金核發機制

- 一、行政院訂定「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」並將相關法規鬆綁，由國發基金及重點領域企業共同挹注資金，協助頂尖大學與重點企業培育產業發展所需人才及補足相關人力需求。為強化學生學以致用的能力及協助補足相關重點產業發展所需科技人才缺口，本研究學院積極引進社會資源，與企業共同培養重點領域產業所需人才；並且建立完善培育機制、就業進路選擇輔導及媒合機制。
 - 二、適用對象：經本研究學院招生錄取入學且與本學院簽署「學生參與實習保密切結書」及「學生獎助金核發與返還同意書」之在學學生(以下簡稱學生)。
 - 三、獎助金措施：
 - (一)本學院引進企業資源，由業界投入培育經費、實習場域所需精密設備儀器、技術與知識、業界師資及相關支援人力，並提供學生在校就學期間之修課/實作獎助金，及學生畢業後至培育企業就業的機會。
 - (二)學生請於報名時提出「參與實習保密切結書」，以配合研究學院規劃培育措施。
 - (三)學生於畢業後應至培育企業就業以二年為原則。具有兵役義務者，其就業期間之其就業期間之採計得配合役期延後至退役後。
 - (四)學生有下列情形之一者，應終止受領獎助金，並返還已受領之獎學金。但死亡者、因重大疾病或事故辦理休學或不能繼續完成學業或工作，經衛生福利部新制醫院評鑑合格之教學醫院以上層級，開立認定無法繼續就學或就業證明者，或因事故致家庭巨變無法繼續就學或就業，經本學院實訪查證，由學院與培育企業核定者，得免返還已受領之獎助金或免履行就業義務：
 1. 因擬轉學、轉所且經學院輔導仍無法延續參與培育或放棄、被應令退學、開除學籍或無故輟學。
 2. 因辦理退學或經核准休學未復學不能繼續完成學業或工作。
 3. 畢業後三個月內未就業。學生畢業後連續就業未滿二年或培育企業規定之最短服務年限(取期間較短者)，應依其未就業之月數比例返還碩一獎助學金；不滿一月者，以一月計。
 - (五)獎助金核發及返還：
 1. 碩一：每學期核發獎助金總額 8 萬元，返還時以學期為單位(每學期 8 萬元)，不足一學期者免返還該學期獎助金。
 2. 碩二、碩三：每學期核發獎助金總額 21-24 萬元，返還時以碩一受領之獎助金總額新臺幣 16 萬元為上限，畢業後亦同。
- 四、保密協定措施：學生碩一至碩三期間規劃 27 學分的企業實習課程，學生應於報名時完成簽署保密切結書。
- 五、學生就學期間，除了參與培育企業之實習課程外，應參與培育企業之現場實作與議題討論，且得列計當學期實習課程之平時成績。

半導體及重點科技研究學院招生報考說明

◆ 簽署「參與實習保密切結書」及「獎助金核發與返還同意書」寄繳

國立中山大學半導體及重點科技研究學院

學生參與實習保密切結書

本人_____報考國立中山大學半導體及重點科技研究學院，同意於錄取入學後安排至合作企業實習期間所知悉取得或持有之任何資訊與個人資料，無論於實習期間或實習終了後，皆應保密，不得洩漏或交付予任何第三人；除經實習企業許可外，本人同意不得任意蒐集、處理、利用實習企業之任何資訊與個人資料，或利用實習企業之任何資訊與個人資料造成其他可能侵害實習企業之行為。倘若因此致實習企業受有任何損害，本人將負一切責任，概與國立中山大學半導體及重點科技研究學院無涉。

此致

國立中山大學半導體及重點科技研究學院

立同意書人：

姓 名：

(簽章)

國立中山大學半導體及重點科技研究學院

學生獎助金核發與返還同意書

本人_____報考國立中山大學半導體及重點科技研究學院，已詳閱並同意國立中山大學半導體及重點科技研究學院「學生參與實習保密及獎助金核發機制」相關規定，並保證未受領其他有約定就業/實習等附帶服務義務之獎助學金，倘若因此致國立中山大學半導體及重點科技研究學院受有任何損害，本人將負一切責任。

此致

國立中山大學半導體及重點科技研究學院

立同意書人：

姓 名：

(簽章)



THANK YOU